

公司代码：688469

公司简称：芯联集成

芯联集成电路制造股份有限公司

2025年年度报告摘要



第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关的内容。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

报告期公司营业收入 81.80 亿元，实现 25.67% 的高速增长；全年毛利率 5.51%，同比提升 4.48 个百分点；归母净利润同比大幅减亏 38.17%，亏损收窄至 -5.95 亿元，盈利能力显著改善。

截至报告期末，公司尚未实现盈利。主要系报告期公司尚处于产线建设初步完成、市场拓展快速增长阶段，产品结构尚未完全优化，规模效益未完全体现。

基于当前强劲的市场需求增长趋势，产品结构的持续优化，碳化硅、模拟 IC 以及功率模块等高附加值业务占比提升，且随着时间推移设备折旧压力逐步降低，为公司盈利改善提供了核心动力。展望未来，公司将完成从芯片代工到系统级方案提供者的全面升级，实现对汽车、AI 服务器、工控及高端消费等关键领域的全覆盖，成为赋能全球新能源与智能化产业的核心力量。

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2025年度利润分配预案为不进行利润分配，不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。以上利润分配预案已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

适用 不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	芯联集成	688469	中芯集成

1.2 公司存托凭证简况

适用 不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张毅	商娴婷
联系地址	浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号	浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号
电话	0575-88421800	0575-88421800
传真	0575-88420899	0575-88420899
电子信箱	IR@unt-c.com	IR@unt-c.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要业务为提供系统代工，主要包含应用于车载、AI（人工智能）、工控、高端消费领域的功率（功率器件、功率 IC、微控制器等）系统代工和信号链（MEMS 传感器\执行器、模拟 IC、信号接口等）系统代工。

1、功率系统代工方面

（1）功率器件

功率器件产品包含 IGBT、MOSFET、SiC MOSFET 芯片及模组，应用于车载、工控、消费、服务器电源等多个应用领域，电压平台覆盖 12V-6500V。其中高压功率器件产品主要应用于车载主驱，OBC（车载充电机）、充电桩、风光储、制氢、电力、服务器电源、电机变频驱动等领域。

（2）功率 IC 和微控制器

功率驱动与控制产品从高电压、大电流和高密度三个维度，提供完整的系统代工服务。其中已成熟量产的 0.18um BCD 平台，能满足电机驱动等各类驱动、电源管理、接口和 AFE（电池管理系统芯片）等终端产品的代工需求；集成单芯片工艺平台 BCD 60V/120V+eflash 已完成多个客户端的产品验证；第二代 90 纳米 BCD 50V/60V/120V 平台已开发完成，配合新能源汽车和工业 4.0 集成 SoC 方案，提供高可靠性和更具成本优势的工艺方案；55 纳米 MCU（嵌入式闪存工艺）平台开发完成，40 纳米 MCU 工艺平台持续开发中。

2、信号链系统代工方面

MEMS 等传感信号链产品包含硅麦克风、激光雷达中的微镜和光源 VCSEL 芯片、压力传感、惯性传感器等。其中应用于高端消费、新能源汽车的第三代麦克风进入量产，第四代麦克风通过初步验证进入产品迭代；车载和消费类多轴运动传感器规模量产；车载激光雷达 VCSEL 芯片大规模量产。

2.2 主要经营模式

由于模块化、集成化的市场需求快速凸显，公司在晶圆代工模式的基础上，持续敏锐捕捉市场需求迭代趋势。在横向维度上，打造了覆盖设计服务、晶圆制造、模组封装、应用验证、可靠性测试环节的一站式系统代工服务体系；在纵向维度上，逐步完成从功率器件、模拟 IC、MCU 到系统方案的全层级布局，构建起“功率-模拟 IC-MCU-系统代工方案”的战略实现路径，全方位满足客户由点到面、从单一芯片到整体应用的全链条代工需求。

基于核心产品线优势，公司继续延伸拓展系统方案能力，形成汽车（包含电驱、电源、电池管理、底盘、热管理、灯、车身控制等）、AI 数据中心（电源、光通信等）、工控、高端消费等领域的系统方案全覆盖能力。依托该模式，公司可为不同类型客户提供更高效、灵活、可靠的整体解决方案，通过深度嵌入客户产品开发全流程，实现各环节协同优化，助力客户提升产品可靠性与性能、降低综合成本、缩短产品上市周期，与客户构筑长期稳定的合作伙伴关系。

同时，公司持续优化升级经营策略，不断丰富一站式系统代工服务模式的内涵与外延，重点推进系统方案的研发与落地，进一步提升与客户合作方式的灵活性和多样性，强化全链条服务壁垒，持续增加客户合作黏性。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

2025年在新能源汽车普及、智能驾驶渗透、AI算力需求爆发及新能源产业回暖等多重因素驱动下，全球半导体行业在周期性调整后实现强劲复苏。新能源汽车、AI（人工智能）、消费电子、风光储等细分领域需求旺盛，带动功率器件、模拟IC等核心产品保持较快增长。根据美国半导体行业协会（SIA）数据，2025年全球半导体销售额达7,917亿美元，同比增长25.6%。

中国作为全球最大的汽车、新能源及消费电子市场，其对半导体产品的需求正随着汽车电动化与智能化、人工智能产业等新兴领域的快速发展而持续增长。工信部数据显示，2025年中国集成电路产量达到4,843亿块，同比增长10.9%。海关总署数据显示，2025年中国集成电路出口额约为2,019亿美元，同比增长26.8%。

① 新能源汽车赛道需求持续增长，智能化有望加速落地

2025年，中国汽车行业受政策拉动需求有所提升，新能源车市场延续增长态势。根据中国汽车工业协会数据，2025年，中国汽车销量3,440.0万辆，同比增长9.4%，其中新能源汽车销量达1,649.0万辆，同比增长28.2%。乘用车方面，据统计，2025年中国乘用车销量3,010.3万辆，同比增长9.2%，其中新能源乘用车销量1,553.7万辆，新能源乘用车渗透率达51.6%。与此同时，随着智能驾驶数据资源积累，算力、大模型等AI技术的迭代升级，智能驾驶有望从量变到质变，智能化成为当前车企的重要发力点。

功率半导体作为汽车电子的核心，是新能源汽车中成本仅次于电池的第二大核心零部件。新能源汽车市场的持续增长和智能化技术的快速发展，将为功率半导体、模拟IC、传感器等半导体带来广阔增量机遇。

② AI算力驱动数据中心革新升级，第三代半导体和MicroLED迎来广阔发展空间

AI数据中心电源领域，大模型及AI应用的不断涌现和迭代，使得全球算力需求呈现增长态势，数据中心建设规模持续扩大、服务器数量增加、单台服务器机柜功耗不断上升。算力的尽头是电力，AI算力的扩张有望持续推动高功率、高效率和高稳定性的AI服务器电源需求增长，为上游功率、模拟及数模混合芯片产业带来了新的市场机遇。

与此同时，算力规模扩张带来的功耗与散热压力持续提升，对AI数据中心电源核心功率器件的性能提出了革命性要求。在此背景下，以碳化硅、氮化镓为代表的第三代半导体功率器件，凭借其优异的高频、高压、低损耗特性，成为适配新一代AI算力基础设施的优选方案。未来随着AI算力基础设施不断升级，特别是AI数据中心800V/±400V高压直流架构（HVDC）持续演

进、固态变压器（SST）逐步实现规模化应用，第三代半导体功率器件市场需求有望迎来快速放量与高速增长。

AI 数据中心传输领域，随着人工智能算力需求快速增长，AI 数据中心内部传输对更高带宽、更低时延和更高能效的要求日益提升，短距高速光通信技术迎来重要发展机遇。MicroLED 光通信方案凭借高集成度、低功耗、高速传输等优势，已成为 AI 数据中心传输领域的重要新方向，并获得行业头部企业的支持。随着 MicroLED 光通信方案大规模导入市场及更高带宽方案逐步落地，其需求量有望大幅增长，预计 2026-2027 年将从实验室研发加速走向产业化应用。

③ 人形机器人产业化提速，核心器件迎发展新机遇

2025 年，中国人形机器人在商业化落地进程中实现突破性进展，核心零部件国产化水平持续提升，量产能力与场景应用逐步成熟，在物流、工业等多个核心场景逐步实现规模化交付。据中国信通院数据，2025 年全球人形机器人市场规模达 170 亿元，中国市场规模突破 85 亿元，占全球比重超 50%。人形机器人从“实验室”走向“大规模商业化”，为传感器、功率半导体及模拟 IC 等上游核心器件注入强劲增长动能。

④ 消费电子需求复苏趋势延续，AI（人工智能）赋能打开全新增长空间

当前全球智能手机、PC、家电行业延续需求回暖趋势。据 Omidia 数据，在 3C 电子领域，2025 年全球智能手机出货量达到 12.5 亿部，同比增长 1.8%，全球 PC 出货量 2.8 亿台，同比增长 9.1%；受益于国补政策，2025 年家电领域行业增长较好，根据国家统计局数据，2025 年中国家用电器和音像器材类社会零售总额增长 11.0%。与此同时，AI 端侧应用正在加速，给手机/PC、可穿戴等硬件产品带来创新和新的机遇，2025 年消费电子行业迎来上行周期。

终端产品的升级换代或将带动消费电子领域 MEMS 传感器芯片、功率器件及模拟 IC 等的整体增长，同时 AI 手机及 AIPC 搭载大模型带来大量计算、高能耗需求，带动电源管理类芯片形成新场景下的增量需求。

⑤ 风光储装机规模快速增长，政策助力新能源产业高质量发展

2025 年，风光储行业在政策引导与市场需求的驱动下，整体保持持续向好的发展态势。国家能源局联合相关部委在报告期内密集出台《分布式光伏发电开发建设管理办法》《新型储能制造业高质量发展行动方案》等一系列新能源产业支持政策，推动新能源产业由规模化扩张向高质量发展阶段加速转型，为我国新能源产业提质增效、迈向高质量快速发展新阶段提供了坚实的政策保障与有力支撑。

根据国家能源局统计，风电领域，2025年中国风电装机6.4亿千瓦，同比增长22.9%，海上风电进入建设大年；光伏领域，分布式光伏新政推动光伏“抢装”，2025年中国太阳能发电装机容量12.0亿千瓦，同比增长35.4%；储能领域，据CESA统计，2025年中国新型储能新增装机规模达196.5GWh，同比增长79.3%（容量）；中国企业同步加快国际化步伐，特别是2025年下半年订单迎来集中爆发，根据CNESA Data Link不完全统计，2025年中国储能企业新增海外订单规模366GWh，同比增长144%。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

芯联集成致力于成为一站式系统代工解决方案的领导者。

在晶圆代工方面，据Chip Insights数据，公司已迈入晶圆代工“第一梯队”，跻身全球专属晶圆代工榜单前十，中国大陆第四。

(1) 功率器件领域，公司是中国最大的车规级IGBT生产基地之一，同时公司在SiC MOSFET出货量上稳居亚洲前列，是国内产业中率先突破主驱用SiC MOSFET产品的头部企业，2025年公司8英寸碳化硅已经实现量产出货；

(2) 模拟IC领域，公司持续开发国内独有、稀缺的高压BCD平台，是国内在该领域布局最完整的企业之一，公司的BCD工艺技术研发已达到国际领先水平，且多个新平台已实现规模量产；

(3) MEMS领域，公司是国内规模最大、技术最先进的MEMS晶圆代工厂；根据Yole发布的《MEMS产业现状2025》，芯联集成位列全球MEMS晶圆代工厂第五名，是中国大陆唯一进入全球前五的MEMS代工企业。

在模组封装方面，公司的功率模块出货量位居中国市场前列。

根据NE时代统计，2025年公司在国内乘用车功率模块装机量排行榜位列第四。

目前公司SiC MOSFET芯片及模组已全面覆盖650-3300V碳化硅工艺平台，产品关键指标均处于国内领先水平。根据Yole发布的2025年碳化硅(SiC)业务排名，公司是中国SiC器件厂商中位居第一的企业。2025年公司碳化硅业务实现同比快速增长，跻身全球前五，并占据约5%的全球市场份额。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

新能源汽车产业深度变革、人工智能技术全面演进、AI算力规模化爆发与AI应用加速推进，共同催生新技术、新业态、新模式，为经济发展注入新的增长动力。

全球汽车产业持续迈向电动化、智能化、低碳化深水区，产业生态由链式协同，网状协作，向跨领域、全方位深度融合加速演进，新能源汽车与能源网、交通网、算力网深度耦合，推动车-路-云一体化协同创新；技术方面，8英寸碳化硅工艺平台规模化量产、氮化镓车载电源加速导入，有效提升电驱效率与续航可靠性，物理级AI与智能驾驶深度融合，推动车规级电源管理、传感、驱动芯片向高集成、高可靠、高效能方向迭代；新业态方面，产业链协同持续深化，芯片制造、封测与应用方案加速融合，整车与供应链从单一器件采购转向系统化、一体化解决方案合作；未来，AI（人工智能）全面应用将持续拉高车载算力需求，第三代半导体成为主流技术路线，为公司带来广阔发展机遇。

2025年AI算力需求进入规模化爆发阶段，智算基础设施进入集中升级阶段，能源供给与数据传输成为支撑算力高效运转的两大关键方向。AI数据中心供配电体系持续向高压化、高效化、模块化方向演进，高可靠、大功率供电方案需求快速提升，电源系统架构持续迭代升级。碳化硅、氮化镓等第三代半导体材料凭借低损耗、高效率的优势，显著提升系统能效与运行稳定性，有力推动功率器件及上游芯片产业创新发展。与此同时，算力互联不断向高速率、低时延、高集成度方向升级，光通信成为破解高带宽传输瓶颈的重要技术路线。MicroLED凭借优异的集成度、低功耗与高速传输特性，逐步由前沿研发迈向产业化预备阶段，为数据中心高速传输领域开辟出新的发展空间。

高端消费领域迎来AI硬件深度普及的新阶段，人工智能由云端向终端全面渗透，智能穿戴、空间交互设备、智能交互玩具等新兴产品快速兴起。终端向轻量化、随身化、沉浸式交互升级，多模态感知、自主交互成为行业重要发展方向。同时具身智能相关产品逐步融入高端消费场景，推动终端形态进一步丰富。技术迭代不断催生新业态、新模式，有力拉动功率、模拟IC、传感器、MCU等核心芯片需求增长，为相关产业带来广阔的发展空间与持续增长动力。

报告期内，基于客户需求，公司系统方案能力正加速构筑与落地。公司持续优化和提升经营策略，不断丰富和升级经营模式，进一步提升公司与客户之间合作方式的灵活性和多样性，增强公司与客户合作的黏性。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年 增减(%)	2023年
总资产	33,180,986,285.55	34,202,723,841.88	-2.99	31,570,366,445.66

归属于上市公司股东的净资产	13,034,362,112.63	12,321,013,873.28	5.79	12,483,074,709.70
营业收入	8,179,732,880.37	6,509,090,845.76	25.67	5,324,482,794.85
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	7,889,401,345.88	6,276,082,906.15	25.71	4,910,739,546.44
利润总额	-1,932,576,414.36	-2,246,503,325.61	减亏13.97%	-2,941,428,756.44
归属于上市公司股东的净利润	-594,893,008.06	-962,159,563.25	减亏38.17%	-1,958,331,781.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,118,722,560.11	-1,409,560,221.69	减亏20.63%	-2,261,685,779.13
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	2,177,565,829.97	2,145,713,627.83	1.48	925,416,752.03
经营活动产生的现金流量净额	2,134,608,728.19	1,902,620,390.86	12.19	2,614,301,648.62
毛利率(%)	5.51	1.03	增加4.48个百分点	-6.81
净利率(%)	-23.63	-34.51	不适用	-55.24
息税折旧摊销前利润率(%)	26.62	32.96	减少6.34个百分点	17.38
加权平均净资产收益率(%)	-4.95	-7.97	增加3.02个百分点	-22.44
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.14	不适用	-0.32
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.14	不适用	-0.32
研发投入占营业收入的比例(%)	23.76	28.30	减少4.54个百分点	28.72

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	1,733,684,310.68	1,761,513,459.49	1,926,756,627.44	2,757,778,482.76

归属于上市公司股东的净利润	-182,289,864.64	11,949,489.86	-292,707,251.85	-131,845,381.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-230,213,235.19	-305,394,892.10	-337,641,244.12	-245,473,188.70
经营活动产生的现金流量净额	171,757,565.56	809,667,569.76	-209,109,538.60	1,362,293,131.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)							128,003
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							128,726
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
绍兴市越城区集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）		1,152,000,000	13.74	1,152,000,000	无		境内 非国 有法 人
中芯国际控股有限公司		993,600,000	11.85	993,600,000	无		境内 非国 有法 人
绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）	454,009,900	454,009,900	5.42	454,009,900	无		境内 非国 有法 人

绍兴硅芯锐企业管理合伙企业（有限合伙）		230,400,000	2.75	230,400,000	无		境内非国有法人
绍兴日芯锐企业管理合伙企业（有限合伙）		216,000,000	2.58	216,000,000	质押	190,000,000	境内非国有法人
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	-22,524,011	196,249,363	2.34		无		其他
香港中央结算有限公司	172,720,643	192,668,633	2.3		无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司—易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	6,105,887	183,361,707	2.19		无		其他
深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	181,603,960	181,603,960	2.17	181,603,960	无		境内非国有法人
厦门辰途华辉创业投资合伙企业（有限合伙）	139,229,702	139,229,702	1.66	139,229,702	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、滨海芯兴与越城基金存在关联关系； 2、硅芯锐、日芯锐存在关联关系； 除了上述股东关联关系外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

存托凭证持有人情况

适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5、公司债券情况

适用 不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
芯联集成电路制造股份有限公司2025年度第一期科技创新债券	25 芯联集成 SCP001(科创债)	012582609	2026-07-27	500,000,000	1.6

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

适用 不适用

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

受评对象	评级机构名称	评级调整时间	评级级别变化	评级展望变化	评级结果变化的原因
芯联集成电路制造股份有限公司	中诚信国际信用评级有限责任公司	2025年7月30日	AAA	稳定	新增

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率(%)	44.69	41.68	3.01
扣除非经常性损益后净利润	-11.19	-14.10	减亏 20.63%
EBITDA 全部债务比	19.40	21.03	-1.63
利息保障倍数	-7.22	-5.34	不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 81.80 亿元，较上年同期增长 25.67%，其中主营业务收入增幅 25.71%，保持了良好的增长势头。归属于上市公司股东的净利润为-5.95 亿元，实现同比大幅减亏 38.17%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用